



鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业

H300-Soft超软系列 【导热硅胶垫片】规格书



-产品图-

应用特点：

- 柔软，可压缩性好
- 热阻抗较小
- 表面自带粘性
- 防火性能高
- 低压力下应用
- 很好的电绝缘性能和耐高温性能

应用领域推荐：

- 芯片与散热模块之间
- 光电行业
- 网通产品
- 汽车电子
- 可穿戴设备

该系列产品符合RoHS、HSF、卤素管控标准。

储存条件：阴暗处储存

储存温度：≤30℃

储存湿度：≤70%

堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1M

保质期：

在储存条件下：二年

不符合储存条件下：六个月

鸿富诚 H300-Soft 导热硅胶垫片，热空穴填料具有优良的柔软性、压缩性和自然表面粘度性能。用于填充间隙，实现加热件与冷却件之间的传热。同时具有绝缘和减震效果，可满足小型和超薄设备的设计要求，具有优良的制造性和实用性。厚度范围广，广泛应用于电子产品中。

产品性能

NO.	参 数	单 位	测试方法
颜 色	天蓝色	---	目视
厚 度	1~4	mm	ASTM D374
硬 度	20±5	Shore 00	ASTM D 2240
密 度	3.01 ±0.5	g/cc	ASTM D 792
拉伸强度	≥0.15	Mpa	ASTM D 412
延 伸 率	≥60	%	ASTM D 412
压 缩 比	≥40 (@50psi)	%	ASTM D 695
阻燃等级	V-0,5V	---	UL-94
使用温度	-50~180	℃	IEC 60068-2-14

热学特性

导热系数	3.0±0.25	W/m•K	ASTM D 5470
热 阻	≤0.7 (@20Psi/1mm)	°Cin ² /W	ASTM D 5470

电学特性

击穿电压	≥8	KV/mm	ASTM D 149
体积电阻率	≥10 ⁸	Ω•cm	ASTM D 257
介电常数	≥2	@1MHz	ASTM D 150
介质损耗	≤0.1	@1MHz	ASTM D 150

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权

